



平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年2月3日

上場会社名 住友ベークライト株式会社
 コード番号 4203 URL <http://www.sumibe.co.jp>

上場取引所 東大

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 林 茂
 問合せ先責任者 (役職名) 経理企画本部副本部長 (氏名) 寺島 郁朗

TEL 03-5462-3452

四半期報告書提出予定日 平成24年2月10日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第3四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第3四半期	141,241	△2.9	5,341	△40.9	6,380	△36.6	3,831	△33.2
23年3月期第3四半期	145,530	16.1	9,044	199.6	10,067	164.6	5,736	—

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 △227百万円 (—%) 23年3月期第3四半期 △501百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第3四半期	15.90	—
23年3月期第3四半期	23.81	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第3四半期	198,791	118,179	58.9
23年3月期	205,090	122,025	59.0

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 117,097百万円 23年3月期 120,933百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	7.50	—	7.50	15.00
24年3月期	—	7.50	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	7.50	15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	190,000	△0.5	8,500	△24.0	10,000	△20.0	4,800	△6.9	19.92

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期3Q	262,952,394 株	23年3月期	262,952,394 株
② 期末自己株式数	24年3月期3Q	22,031,523 株	23年3月期	22,024,150 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期3Q	240,924,547 株	23年3月期3Q	240,945,521 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報(その他)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(四半期連結損益計算書)	
(第3四半期連結累計期間)	6
(四半期連結包括利益計算書)	
(第3四半期連結累計期間)	7
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) セグメント情報等	8
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
(6) 重要な後発事象	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間の世界経済は、欧州の財政・金融不安や、米国での景気低迷が続くなか、これまで牽引役であった中国などの新興国においてもインフレ対策の金融引き締め政策や輸出の減少により、成長が鈍化するなど、景気の減速感が強まりました。

日本経済は、東日本大震災後のサプライチェーンの立て直しがほぼ終了し、緩やかに持ち直してきました。しかし、歴史的な円高の継続や欧州の財政危機の再燃に加え、タイの大規模洪水等厳しい状況が続きました。

当社グループを取り巻く経営環境は、半導体においてはスマートフォンやタブレット型多機能携帯端末は好調でしたが、景気の減速に伴う在庫調整やタイの洪水の影響などにより薄型テレビやパソコン向けなどの需要が低迷し、全体としては低調でした。自動車につきましては、国内の生産は震災からの立ち上がりがあったものの、米国は回復途上であり、中国においても購入促進政策が大幅に縮小されるなど販売の減速が鮮明となり、先行きに陰りが見えてきました。また、国内の住宅着工件数は、震災の影響から持ち直しつつあり、緩やかな回復基調が続いていますが、復興需要による本格的な回復にはいたりませんでした。

当社グループは、このような経営環境の中、身の丈経営によりスリム化した企業体質を維持しながら、次の方針を掲げて新たな成長に向けて会社総合力を結集して取り組んできました。

- ①既存製品の拡販、用途拡大
- ②成長市場・分野での事業拡大
- ③新製品の早期戦力化、ソリューションの創出・提供

この結果、当第3四半期連結累計期間の経営成績につきましては、連結売上高は、高機能プラスチック製品の販売が増加しましたが、円高により在外子会社の売上高が為替換算で大きく減少したため、1,412億41百万円（前年同期比2.9%減）となりました。

利益につきましても、固定費の抑制や不採算事業の構造改革に注力してきましたが、円の高止まりや原料価格の上昇などの悪化要因が大きく、連結営業利益は53億41百万円（前年同期比40.9%減）、連結経常利益は63億80百万円（同36.6%減）、連結純利益は38億31百万円（同33.2%減）となりました。

セグメント別販売状況(対前年同期比較)

①半導体関連材料

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、半導体実装用キャリアテープは、多機能携帯端末などの新分野が好調でしたが、薄型テレビやパソコンなどの既存分野で低迷したことや、円高の影響により売上高は減少しました。

半導体基板材料「LαZ[®]」は、スマートフォンやタブレット端末での採用が拡大し、売上高は順調に伸長しました。

なお、半導体基板材料「LαZ[®]」は、今後の大幅な需要拡大に対応すべく静岡工場の現有設備の能力増強に加えて、宇都宮工場内に第二の生産拠点を設置する予定です。

また、昨年6月末に研究体制を再編し、宇都宮地区の研究所を先端材料研究開発・新分野の開拓に特化させ、既存製品の応用研究は顧客に近い拠点で行うべく、既に設置済のシンガポール、中国蘇州に加え、九州と台湾にも研究所を設置することを決定し準備を進めております。

②回路製品

エポキシ樹脂銅張積層板およびフェノール樹脂銅張積層板は、主に薄型テレビなどの民生機器向けが低調で、売上高は減少しました。

また、フレキシブル・プリント回路は、一部の不採算分野からの撤退により売上高は減少しましたが、固定費の削減等合理化施策の実施により、当初計画どおりの損益の改善を進めました。

③高機能プラスチック

フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂および成形品は、国内では自動車分野は震災やタイの洪水による影響がありましたが、産業資材分野の鉄鋼関連・住宅設備関連は好調に推移し、欧州や北米では自動車分野を中心に堅調に推移したことで、売上高は全体として増加しました。

なお、工業用フェノール樹脂の生産販売会社として中国江蘇省南通市に設立した「南通住友電木有限公司」に、中国市場の需要拡大への対応を図るべくフェノール樹脂成形材料工場も建設中で、現在、本格稼働に向けて準備を進めております。

④クオリティオブライフ関連製品

医療機器製品は、前期末の震災時緊急需要の反動がありましたが、胃瘻用ボタンおよび胃瘻造設キットの伸長と、腹腔用低圧持続ドレナージシステム「クリオドレインバック®」、止血剤注入キット「ポルヒールスプレーセット®」などの新製品の寄与により、売上高は増加しました。

ビニル樹脂シートおよび複合シートは、医薬品包装用途が好調であったものの、工業用途が在庫調整などにより伸び悩み、全体として売上高は減少しました。

ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板、メラミン樹脂化粧板・不燃板などのプレート・デコラ事業は、震災の影響が大きく、売上高は減少しました。なお、新しく開発した不燃認定取得済みのメラミン化粧シート「デコライノベア」をこの事業の柱に育成すべく、昨年8月にプロジェクトチームを結成し、拡販活動を行っております。

防水関連事業は、政府の住宅取得支援策などにより住宅リフォーム関連は堅調に推移し、主力の新築住宅関連も震災などの影響からの立ち上がりを見せ始めたことにより、売上高は増加しました。

なお、防水関連事業は、昨年7月より当社内の製造部門を住ベシート防水㈱に移管し、製造から販売・工事施工までを一貫して同社で行うことで、顧客対応を強化し一層の事業拡大に取り組んでおります。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産、負債および純資産の状況)

①資産の部

総資産は、前連結会計年度末に比べ62億99百万円減少し、1,987億91百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金が38億12百万円、たな卸資産が27億95百万円増加した一方で、現金及び預金が150億36百万円減少したことおよび在外子会社の換算レートが前連結会計年度末に比べ円高に進行したため資産の円換算額が減少したことによるものであります。

②負債の部

負債合計は、前連結会計年度末に比べ24億53百万円減少し、806億11百万円となりました。

これは主に、退職給付引当金が19億24百万円、賞与引当金が12億27百万円減少したことによるものであります。

③純資産の部

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ38億46百万円減少し、1,181億79百万円となりました。

これは主に、四半期純利益を38億31百万円計上した一方で、配当金の支払36億13百万円があったこと、為替換算調整勘定が31億20百万円減少したことおよびその他有価証券評価差額金が11億66百万円減少したことによるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成23年11月7日に公表いたしました業績予想の見直しは現時点では行っておりません。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	38,774	23,738
受取手形及び売掛金	40,560	44,372
商品及び製品	8,709	9,435
半製品	2,573	2,903
仕掛品	582	978
原材料及び貯蔵品	9,128	10,471
その他	6,342	7,406
貸倒引当金	△179	△104
流動資産合計	106,492	99,200
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	30,245	29,093
機械装置及び運搬具（純額）	24,172	23,494
その他（純額）	18,773	21,344
有形固定資産合計	73,191	73,933
無形固定資産		
のれん	5,255	4,906
その他	1,131	1,015
無形固定資産合計	6,387	5,922
投資その他の資産	19,019	19,735
固定資産合計	98,597	99,590
資産合計	205,090	198,791

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	28,681	29,381
短期借入金	5,157	5,111
コマーシャル・ペーパー	11,000	10,000
未払法人税等	1,199	1,137
賞与引当金	2,670	1,443
災害損失引当金	1,034	829
その他	10,832	12,919
流動負債合計	60,574	60,822
固定負債		
長期借入金	11,501	11,050
退職給付引当金	6,702	4,778
事業再建費用引当金	363	395
その他の引当金	370	358
負ののれん	790	294
その他	2,761	2,911
固定負債合計	22,490	19,789
負債合計	83,064	80,611
純資産の部		
株主資本		
資本金	37,143	37,143
資本剰余金	35,358	35,358
利益剰余金	79,140	79,357
自己株式	△11,925	△11,929
株主資本合計	139,716	139,930
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,287	120
為替換算調整勘定	△18,570	△21,690
在外子会社の退職給付債務調整額	△1,499	△1,263
その他の包括利益累計額合計	△18,782	△22,832
少数株主持分	1,092	1,082
純資産合計	122,025	118,179
負債純資産合計	205,090	198,791

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
売上高	145,530	141,241
売上原価	103,745	102,832
売上総利益	41,784	38,408
販売費及び一般管理費	32,740	33,067
営業利益	9,044	5,341
営業外収益		
受取利息	75	112
受取配当金	510	481
負ののれん償却額	615	496
持分法による投資利益	99	0
為替差益	104	261
雑収入	236	191
営業外収益合計	1,642	1,543
営業外費用		
支払利息	256	242
雑損失	362	261
営業外費用合計	619	504
経常利益	10,067	6,380
特別利益		
固定資産売却益	221	24
退職給付引当金戻入額	—	395
その他	4	—
特別利益合計	226	420
特別損失		
固定資産除売却損	475	462
投資有価証券評価損	307	47
事業再建関連費用	369	71
減損損失	419	122
解決金等	341	602
環境対策引当金繰入額	73	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	79	—
その他	35	154
特別損失合計	2,102	1,461
税金等調整前四半期純利益	8,190	5,338
法人税、住民税及び事業税	1,584	1,365
法人税等調整額	737	45
法人税等合計	2,321	1,410
少数株主損益調整前四半期純利益	5,869	3,928
少数株主利益	132	97
四半期純利益	5,736	3,831

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	5,869	3,928
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△446	△1,166
為替換算調整勘定	△5,988	△3,219
在外子会社の退職給付債務調整額	68	236
持分法適用会社に対する持分相当額	△4	△5
その他の包括利益合計	△6,371	△4,155
四半期包括利益	△501	△227
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△550	△218
少数株主に係る四半期包括利益	48	△8

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

I 前第3四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期 連結損 益計算 書計上 額 (注) 3
	半導体 関連材料	回路製品	高機能 プラス チック	クオリテ イオブラ イフ関連 製品	計				
売上高									
外部顧客への売上高	40,777	14,851	45,326	44,046	145,002	528	145,530	—	145,530
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	278	171	449	—	449	△449	—
計	40,777	14,851	45,604	44,217	145,451	528	145,979	△449	145,530
セグメント利益又は 損失(△)	5,511	△1,283	5,089	2,363	11,681	△1	11,679	△2,634	9,044

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、試験研究の受託、土地の賃貸等を含んでおります。

2 「セグメント利益又は損失(△)」の調整額△2,634百万円には、セグメント間取引消去8百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,642百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究費用等であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期 連結損 益計算 書計上 額 (注) 3
	半導体 関連材料	回路製品	高機能 プラス チック	クオリテ イオブラ イフ関連 製品	計				
売上高									
外部顧客への売上高	39,235	11,883	45,793	43,792	140,705	535	141,241	—	141,241
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	246	62	308	—	308	△308	—
計	39,235	11,883	46,040	43,855	141,014	535	141,550	△308	141,241
セグメント利益又は 損失(△)	2,452	△684	3,980	2,421	8,169	14	8,183	△2,842	5,341

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、試験研究の受託、土地の賃貸等を含んでおります。

2 「セグメント利益又は損失(△)」の調整額△2,842百万円には、セグメント間取引消去7百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,850百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究費用等であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

各報告セグメントの主要な製品および役務の内容は以下のとおりであります。

報告セグメント	主要な製品および役務の内容
半導体関連材料	半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、感光性ウェハーコート用液状樹脂、半導体用液状樹脂、半導体実装用キャリアテープ、半導体チップ接着用テープ、半導体基板材料
回路製品	フレキシブル・プリント回路、フェノール樹脂銅張積層板、エポキシ樹脂銅張積層板
高機能プラスチック	フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂、精密成形品、合成樹脂接着剤
クオリティオブライフ関連製品	医療機器製品、メラミン樹脂化粧板・不燃板、ビニル樹脂シートおよび複合シート、鮮度保持フィルム、ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板、防水工事の設計ならびに施工請負、バイオ製品

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(6) 重要な後発事象

該当事項はありません。